

工程	能力	ウェハサイズ	
		6インチ	8インチ
フォトリソグラフィ	コーティング	✓	✓
	コーティング(両面对応)	✓	
	コーティング(スプレー)	✓	✓
	現像	✓	✓
	現像(両面对応)	✓	
	ステッパー	✓	
	アライナー	✓	✓
ボンディング	ボンダー	✓	
ドライエッチング	Si DRIE(Deep Reactive Ion Etching)	✓	
	ポリシリコン	✓	
	誘電体	✓	✓
	金属	✓	
	ガラス DRIE(Deep Reactive Ion Etching)	✓	✓
ウェットエッチング	ウェハクリーン	✓	
	Si	✓	
	SiO	✓	
	SiN	✓	
	金属	✓	
	リフトオフ	✓	✓
	フォトレジスト・ストリップ(PR-Strip)	✓	✓
スパッタ	メタルスパッタ	✓	
	反応性スパッタ	✓	
蒸着	金属	✓	✓
電解メッキ	銅メッキ	✓	
PECVD	Si	✓	
	SiN	✓	✓
	SiO2	✓	✓
	SiC	✓	
	PSG	✓	
	BPSG	✓	
熱処理成膜	熱酸化膜	✓	
	アニール処理	✓	
	合金	✓	
LPCVD	ポリシリコン	✓	
	SiN	✓	
イオン注入	中電流	✓	
	高電流	✓	
研削(Grinding)	粗研磨	✓	
	微研磨	✓	
	超微研磨	✓	
ブレードダイシング	シリコンダイシング	✓	
	ガラスダイシング	✓	
WAT/CPテスト	プローブ検査	✓	
	マニュアル検査	✓	
計測	CD-SEM	✓	
	光学式膜厚計	✓	
	偏光解析	✓	
	強度計測	✓	
	表面形状測定	✓	
	3D測定	✓	
	IR顕微鏡	✓	
	白色光干渉計	✓	